

积层陶瓷电容 规格书

产品系列

NV1206B103K202CEGN

产品名称

1206,X7R,10.0nF,±10%,2kV

1. 产品简介

汇聚高压设计产品使用无铅/镉元素材料制作。此系列特性产品可应用于较高电压的应用环境。其由精确的介电材料和适当的导电浆料配制，自动化制程的稳定生产和严谨的质量精确管控了介电设计厚度、电极完整性以及端电极连接的良好特性，实现了最佳可靠度的产品性能。

2. 特点

- 2.1. 特殊结构设计提供较佳耐压水准
- 2.2. 端电极无铅化
- 2.3. 符合 RoHS 标准
- 2.4. 高可靠性和稳定性

3. 用途

- 3.1. 高压耦合/直流阻断
- 3.2. 背光逆变器
- 3.3. LAN/WLAN 接口
- 3.4. 调制解调器
- 3.5. 电源

4. 型号标示:

NV	1206	B	103	K	202	C	E	G	N
系列	外型尺寸	介电质	电容量	公差	额定电压	端接类型	包装	厚度	管理码
表 1	表 2	表 3	表 4	表 5	表 6	表 7	表 8	表 9	表 10

表 1	系列
代码	说明
NV	常规品-高电压,额定电压 1000V~3000V

表 2	外型尺寸		
代码	说明: L x W (mm)	代码	说明: L x W (mm)
0603	1.60 x 0.80	1210	3.20 x 2.50
0805	2.00 x 1.25	1812	4.50 x 3.20
1206	3.20 x 1.60	2220	5.70 x 5.00

表 3	介电质		
代码	说明	代码	说明
N	NPO(C0G)	H	C0H
B	X7R	X	X5R
D	X7E	S	X6R

表 4	电容量		
代码	说明	代码	说明
R47	0.47pF	100	10x10 ⁰ =10pF
0R5	0.5pF	104	10x10 ⁴ =100nF

表 5	公差		
代码	说明	代码	说明
A	±0.05 pF	G	±2 %
B	±0.10 pF	J	±5 %
C	±0.25 pF	K	±10 %
D	±0.50 pF	M	±20 %
F	±1 %	Z	-20% ~ +80%

表 6	额定电压		
代码	说明	代码	说明
6R3	6.3V	101	(10) x 10 ¹ = 100V
100	(10) x 10 ⁰ = 10V	102	(10) x 10 ² = 1000V

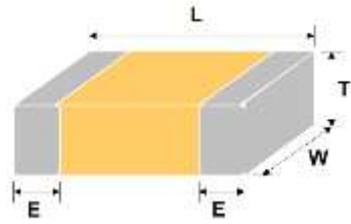
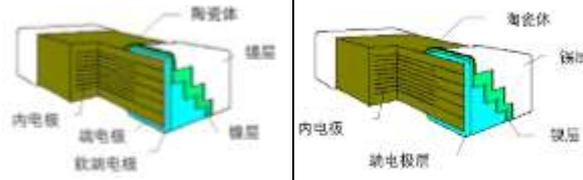
表 7	端接类型		
代码	说明	代码	说明
L	Ag+Ni+Sn	C	Cu+Ni+Sn
B	Ag+Soft E+Ni+Sn	E	Cu+Soft E+Ni+Sn

表 8	包装		
代码	说明	代码	说明
P	7" Reel 卷装-纸带	E	7" Reel 卷装-塑料带
R	13" Reel 卷装-纸带	L	13" Reel 卷装-纸带
B	成品散料包装		

表 9	厚度		
代码	说明	代码	说明
A	0.60 ± 0.10 mm	M	2.50 ± 0.30 mm
B	0.8 ± 0.10 mm	O	3.50 ± 0.20 mm
C	0.95 ± 0.10 mm	P	1.60 + 0.30 / -0.10mm
D	1.25 ± 0.10 mm	R	3.10 ± 0.20 mm
G	1.60 ± 0.20 mm	S	0.80 ± 0.07 mm
J	1.15 ± 0.15 mm	U	2.80 ± 0.30 mm
K	2.00 ± 0.20 mm	X	0.80 + 0.50 / -0.10mm

表 10	电容量		
代码	说明	代码	说明
N	无特殊需求		

5.外型尺寸

英制尺寸	长度 (L) (mm)	宽度 (W) (mm)	厚度 (T) (mm)	端电极宽 (E) (mm)	
0805	2.10±0.20	1.25±0.20	参阅 4.型号标示 表 9	0.50±0.20	 <p>芯片外观图示</p>
1206	3.30±0.30	1.60+0.30/-0.10		0.45±0.10	
1210	3.30±0.40	2.50±0.30		0.45±0.10	
1808	4.60±0.50	2.00±0.20		0.75±0.35	
1812	4.60±0.50	3.20±0.30		0.75±0.35	 <p>芯片结构图示(软端电极) 芯片结构图示(非软端电极)</p>
1825	4.60±0.50	6.30±0.40		0.75±0.35	
2211	5.70±0.50	2.80±0.30		0.85±0.35	
2220	5.70±0.50	5.00±0.40		0.85±0.35	
2225	5.70±0.50	6.30±0.40		0.85±0.35	

6.一般电气规格

介电材料	X7R	
EIA 尺寸	1206	
额定电压	2000V	
电容范围	10.0nF	
电容公差值	±10 %	
损耗角正切 (Tan δ) & 品质因数 (Q)	额定电压	Tan δ (D.F.)
	1000~3000V	≤ 2.5%
检测条件	预处理 (2 类产品) 150±10°C / 1 小时热处理后静置于常温环境 24±2 小时,再进行测量作业 适用检测: 1.0±0.2Vrms 1.0kHz±10% 25°C 常温环境	
绝缘电阻 (IR)	≥10GΩ 或 R•C≥100Ω-F 任一较小值以上	
工作温度	- 55°C to + 125 °C	
温度系数	±15%	
端电极材料	铜/ 镍 / 锡 (无铅端电极)	

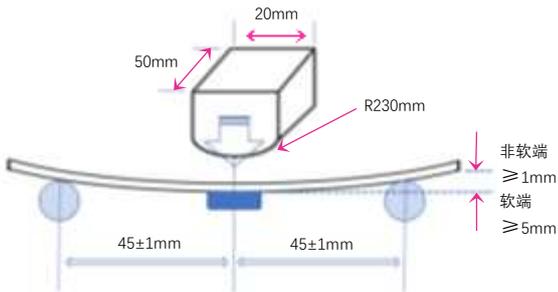
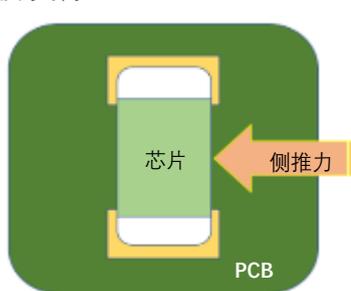
7.可靠度检测条件与质量要求

序号	项目	检测条件	质量要求													
1.	外观	---	*目视无明显可见缺陷 *外型尺寸符合规格标准													
2.	电容量	1类产品: Cap≤1000pF, 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% Cap>1000pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% 2类产品: Cap≤10μF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%	*不可超出规范定义范围													
3.	Q值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	1类产品: Cap≤1000pF, 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% Cap>1000pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% 2类产品: Cap≤10μF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>介电类别</th> <th>额定电压</th> <th>Q/D.F.</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Class II</td> <td>25V</td> <td>D.F. < 3.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">≥50</td> <td>D.F. < 2.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D.F. < 3.0%</td> <td>0603≥0.047μF 0805≥0.18μF 1206≥0.47μF</td> </tr> </tbody> </table>	介电类别	额定电压	Q/D.F.	备注	Class II	25V	D.F. < 3.5%		≥50	D.F. < 2.5%		D.F. < 3.0%	0603≥0.047μF 0805≥0.18μF 1206≥0.47μF
介电类别	额定电压	Q/D.F.	备注													
Class II	25V	D.F. < 3.5%														
	≥50	D.F. < 2.5%														
		D.F. < 3.0%	0603≥0.047μF 0805≥0.18μF 1206≥0.47μF													
4.	温度特性	无外加电压 <table border="1"> <thead> <tr> <th>介电特性</th> <th>操作温度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X7R</td> <td>-55~125°C at 25°C</td> </tr> </tbody> </table>	介电特性	操作温度	X7R	-55~125°C at 25°C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>介电特性</th> <th>电容量变异率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X7R</td> <td>介于±15%之间</td> </tr> </tbody> </table>	介电特性	电容量变异率	X7R	介于±15%之间					
介电特性	操作温度															
X7R	-55~125°C at 25°C															
介电特性	电容量变异率															
X7R	介于±15%之间															
5.	耐电压	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压 (V)</th> <th>量测条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>1.0 倍额定电压</td> </tr> </tbody> </table> *测试电压升压速率 500v/sec *持压时间: 1 to 5 sec *充放电电流 < 50mA	额定电压 (V)	量测条件	2000	1.0 倍额定电压	*无击穿或是闪火现象									
额定电压 (V)	量测条件															
2000	1.0 倍额定电压															
6.	绝缘电阻 (IR)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压 (V)</th> <th>外加电压</th> <th>充电时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 500</td> <td>500VDC</td> <td>60 sec</td> </tr> </tbody> </table>	额定电压 (V)	外加电压	充电时间	> 500	500VDC	60 sec	<table border="1"> <thead> <tr> <th>介电类别</th> <th>要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2类</td> <td>≥10GΩ 或 RxC ≥ 100Ω-F 取任一较小值判定</td> </tr> </tbody> </table>	介电类别	要求	2类	≥10GΩ 或 RxC ≥ 100Ω-F 取任一较小值判定			
额定电压 (V)	外加电压	充电时间														
> 500	500VDC	60 sec														
介电类别	要求															
2类	≥10GΩ 或 RxC ≥ 100Ω-F 取任一较小值判定															
7.	可焊性	* 焊锡温度: 235±5°C 适用 (0603~1210) * 焊锡温度: 245±5°C 适用 (1808~2225) * 浸渍时间: 2±0.5 sec	*端电极上的焊锡层覆盖率不小于 75%													
8.	耐焊锡热	*预处理 (2类产品): 150±10°C / 1 小时热处理后静置于常温环境 48±4 小时,再进行测量作业 *预热处理: 焊锡浸渍前必须先进行 120~150°C / 1 分钟 预热* 焊锡温度: 260±5°C *浸渍时间: 10±1 sec *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验: (1类) 24±2 小时 (2类) 48±4 小时	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>介电类别</td> <td>2类</td> </tr> <tr> <td>端电极外观</td> <td>目视无明显可见缺陷</td> </tr> <tr> <td>电容量变化</td> <td>介于±7.5%之间</td> </tr> <tr> <td>Q值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td> <td>符合初始标准</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻 I.R</td> <td>符合初始标准</td> </tr> <tr> <td>耐电压</td> <td>符合初始标准</td> </tr> </tbody> </table>	介电类别	2类	端电极外观	目视无明显可见缺陷	电容量变化	介于±7.5%之间	Q值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	符合初始标准	绝缘电阻 I.R	符合初始标准	耐电压	符合初始标准	
介电类别	2类															
端电极外观	目视无明显可见缺陷															
电容量变化	介于±7.5%之间															
Q值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	符合初始标准															
绝缘电阻 I.R	符合初始标准															
耐电压	符合初始标准															

7.可靠度检测条件与质量要求

序号	项目	测试条件	质量要求																											
9.	温度循环	*预处理 (2类产品): 150±10°C /1 小时热处理后静置于常温环境 48±4 小时,再进行测量作业 *参照下表原则执行 5 回次循环测试. <table border="1"> <thead> <tr> <th>步骤</th> <th>温度.(°C)</th> <th>时间(分钟)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>最低工作温度.+0/-3</td> <td>30±3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>常温</td> <td>2~3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>最高工作温度.+0/-3</td> <td>30±3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>常温</td> <td>2~3</td> </tr> </tbody> </table> *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; (2类) 48±4 小时	步骤	温度.(°C)	时间(分钟)	1	最低工作温度.+0/-3	30±3	2	常温	2~3	3	最高工作温度.+0/-3	30±3	4	常温	2~3	<table border="1"> <tr> <td>介电类别</td> <td>2类</td> </tr> <tr> <td>端电极外观</td> <td>目视无明显可见缺陷.</td> </tr> <tr> <td>电容量变化</td> <td>X7R 介于±7.5%之间</td> </tr> <tr> <td>Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td> <td>≤1.5(D.F.)×初始值</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻</td> <td>符合初始标准</td> </tr> <tr> <td>耐电压</td> <td>符合初始标准</td> </tr> </table>	介电类别	2类	端电极外观	目视无明显可见缺陷.	电容量变化	X7R 介于±7.5%之间	Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	≤1.5(D.F.)×初始值	绝缘电阻	符合初始标准	耐电压	符合初始标准
			步骤	温度.(°C)	时间(分钟)																									
			1	最低工作温度.+0/-3	30±3																									
			2	常温	2~3																									
			3	最高工作温度.+0/-3	30±3																									
			4	常温	2~3																									
			介电类别	2类																										
			端电极外观	目视无明显可见缺陷.																										
电容量变化	X7R 介于±7.5%之间																													
Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	≤1.5(D.F.)×初始值																													
绝缘电阻	符合初始标准																													
耐电压	符合初始标准																													
10.	耐湿性	*预处理 (2类产品): 150±10°C /1 小时热处理后静置于常温环境 48±4 小时,再进行测量作业 *测试温度: 40±2°C *环境湿度: 90~95% RH *测试时间: 500+24/-0hrs *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; (2类) 48±4 小时	<table border="1"> <tr> <td>介电类别</td> <td>2类</td> </tr> <tr> <td>端电极外观</td> <td>目视无明显可见缺陷</td> </tr> <tr> <td>电容量变化</td> <td>X7R 介于±12.5%之间</td> </tr> <tr> <td>Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td> <td>D.F. ≤200%×初始值</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻 I.R</td> <td>≥1GΩ 或 R•C ≥50Ω-F 取任一较小值判定</td> </tr> </table>	介电类别	2类	端电极外观	目视无明显可见缺陷	电容量变化	X7R 介于±12.5%之间	Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	D.F. ≤200%×初始值	绝缘电阻 I.R	≥1GΩ 或 R•C ≥50Ω-F 取任一较小值判定																	
			介电类别	2类																										
			端电极外观	目视无明显可见缺陷																										
			电容量变化	X7R 介于±12.5%之间																										
			Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	D.F. ≤200%×初始值																										
			绝缘电阻 I.R	≥1GΩ 或 R•C ≥50Ω-F 取任一较小值判定																										
11.	耐湿负载	*预处理 (2类产品): 150±10°C /1 小时热处理后静置于常温环境 48±4 小时,再进行测量作业 *测试温度: 40±2°C *环境湿度: 90~95% RH *测试时间: 500+24/-0hrs *外加电压: 额定电压 *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验; (2类) 48±4 小时	<table border="1"> <tr> <td>介电类别</td> <td>2类</td> </tr> <tr> <td>端电极外观</td> <td>目视无明显可见缺陷</td> </tr> <tr> <td>电容量变化</td> <td>X7R 介于±12.5%之间</td> </tr> <tr> <td>Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td> <td>D.F. ≤200%×初始值</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻 I.R</td> <td>≥1GΩ 或 R•C ≥50Ω-F 取任一较小值判定</td> </tr> </table>	介电类别	2类	端电极外观	目视无明显可见缺陷	电容量变化	X7R 介于±12.5%之间	Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	D.F. ≤200%×初始值	绝缘电阻 I.R	≥1GΩ 或 R•C ≥50Ω-F 取任一较小值判定																	
			介电类别	2类																										
			端电极外观	目视无明显可见缺陷																										
			电容量变化	X7R 介于±12.5%之间																										
			Q值或损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	D.F. ≤200%×初始值																										
绝缘电阻 I.R	≥1GΩ 或 R•C ≥50Ω-F 取任一较小值判定																													

7.可靠度检测条件与质量要求

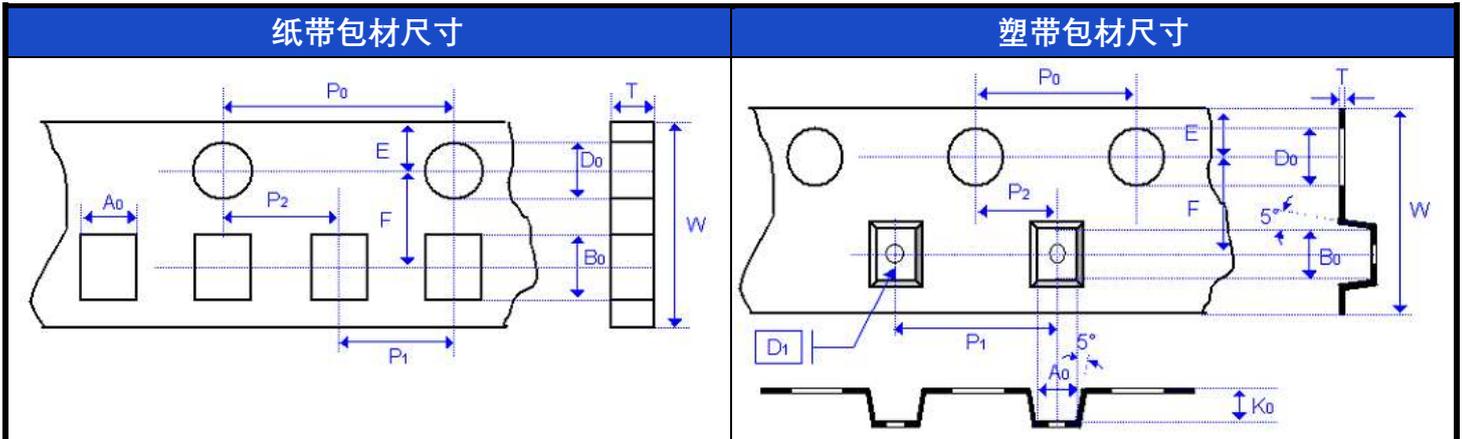
序号	项目	测试条件	质量要求														
12.	高温负荷	*需将芯片通过 reflow 焊接于 PCB 板上 *测试温度: 125±3°C <table border="1"> <tr> <td>R 额定电压(V)</td> <td>外加电压</td> </tr> <tr> <td>1000<V≤5000V</td> <td>1.0 倍额定电压</td> </tr> </table> *测试时程: 1000+24/-0 hrs *后处理: 作业后于常温标准状态下静置一段时间再行检验: (2类) 48±4 小时	R 额定电压(V)	外加电压	1000<V≤5000V	1.0 倍额定电压	<table border="1"> <tr> <td>介电类别</td> <td>2 类</td> </tr> <tr> <td>端电极外观</td> <td>目视无明显可见缺陷</td> </tr> <tr> <td>容量变化</td> <td>X7R 介于±12.5%之间</td> </tr> <tr> <td>Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)</td> <td>D.F. ≤200×初始值</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻 I.R</td> <td>≥1GΩ 或 R•C≥50Ω-F 取任一较小值判定</td> </tr> </table>	介电类别	2 类	端电极外观	目视无明显可见缺陷	容量变化	X7R 介于±12.5%之间	Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	D.F. ≤200×初始值	绝缘电阻 I.R	≥1GΩ 或 R•C≥50Ω-F 取任一较小值判定
		R 额定电压(V)	外加电压														
1000<V≤5000V	1.0 倍额定电压																
介电类别	2 类																
端电极外观	目视无明显可见缺陷																
容量变化	X7R 介于±12.5%之间																
Q 值 或 损耗角正切 (Tan δ) (D.F.)	D.F. ≤200×初始值																
绝缘电阻 I.R	≥1GΩ 或 R•C≥50Ω-F 取任一较小值判定																
13.	挠曲试验	*焊接在印刷电路板上的芯片元件必须能承受至少基板弯曲: 非软端品≥1mm 程度 / 软端品≥5mm 程度 *使用圆径 230mm/宽度 20mm/长度 50mm 的压杆进行测试时 必须推压印刷电路板的中心点位置 (同芯片元件中心点), 推压 速度为 1mm/秒,持续推压直到需求弯曲程度或是失效为止	<table border="1"> <tr> <td>介电类别</td> <td>2 类</td> </tr> <tr> <td>端电极外观</td> <td>目视无明显可见缺陷</td> </tr> <tr> <td>容量变化</td> <td>X7R 介于±12.5%之间</td> </tr> </table> (电容量的差异变化量参考点为板弯零点 (未弯曲) 数值.)	介电类别	2 类	端电极外观	目视无明显可见缺陷	容量变化	X7R 介于±12.5%之间								
		介电类别	2 类														
端电极外观	目视无明显可见缺陷																
容量变化	X7R 介于±12.5%之间																
																	
14.	端极强度	*将芯片焊接在基板上. 从侧面方向在芯片两端电极间的中心位置 施加一个 5N(≤0603) 或 10N(> 0603) 的垂直力, 并维持加压 侧推 10±1 秒的时间	*芯片元件无产生目视可见缺损缺陷, 或由印刷线路板上脱落														
																	
15.	振动试验	* 振动频率 : 10~55 Hz/每分 * 振幅(amplitude) : 1.5mm * 检验时间 : 6 小时(X/Y/Z 每三方向 各 2 小时)	*芯片元件无产生目视可见缺损缺陷, 或由印刷线路板上脱落 *电容变异 & Q/DF: 符合初始规格														

8.包装尺寸规格及数量

尺寸	厚度 (mm)	纸带		塑带	
		7" 卷轮	13" 卷轮	7" 卷轮	13"卷轮
0603	0.80±0.07	4K	15K	-	-
	0.80+0.15/-0.10	4K	15K		
0805	0.60±0.10	4K	15K	-	-
	0.80±0.10	4K	15K	-	-
	1.25±0.10	-	-	3K	10K
	1.25±0.20	-	-	3K	-
1206	0.80±0.10	4K	15K	-	-
	0.95±0.10	-	-	3K	10K
	1.25±0.10	-	-	3K	10K
	1.60±0.20	-	-	2K	-
1210	0.95±0.10	-	-	3K	10K
	1.25±0.10	-	-	3K	10K
	1.60±0.20	-	-	2K	-
	2.50±0.30	-	-	1K	-
1808	1.25±0.10	-	-	2K	-
	1.60±0.20	-	-	2K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
1812	1.25±0.10	-	-	1K	-
	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
1825	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
	2.80±0.30	-	-	0.5K	-
2211	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
2220	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
	2.80±0.30	-	-	0.5K	-
2225	1.60±0.20	-	-	1K	-
	2.00±0.20	-	-	1K	-
	2.50±0.30	-	-	0.5K	-
	2.80±0.30	-	-	0.5K	-

包装数量单位: pcs

9. 包装尺寸规格及数量



外型尺寸	0603		0805		1206		
芯片厚度	0.80±0.07	0.80+0.15/-0.10	0.80±0.10	1.25±0.10 1.25±0.20	0.80±0.10	0.95±0.10 1.25±0.10	1.60±0.20 1.60+0.3/-0.1
A ₀	1.00+0.05/-0.10	1.02+0.05/-0.10	1.50±0.10	<1.65	2.00±0.10	<2.00	<2.00
B ₀	1.80±0.10	1.80±0.10	2.30±0.10	<2.40	3.50±0.10	<3.60	<3.70
T	0.95±0.05	0.97±0.05	0.95±0.05	0.23±0.05	0.95±0.05	0.23±0.05	0.23±0.05
K ₀	-	-	-	<2.50	-	<2.50	<2.50
W	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10
P ₀	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
10×P ₀	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20
P ₁	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
P ₂	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05
D ₀	1.55±0.05	1.55±0.05	1.55±0.05	1.50±0.10/-0	1.55±0.05	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0
D ₁	-	-	-	1.00±0.10	-	1.00±0.10	1.00±0.10
E	1.75±0.05	1.75±0.05	1.75±0.05	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10
F	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05	3.50±0.05
尺寸单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

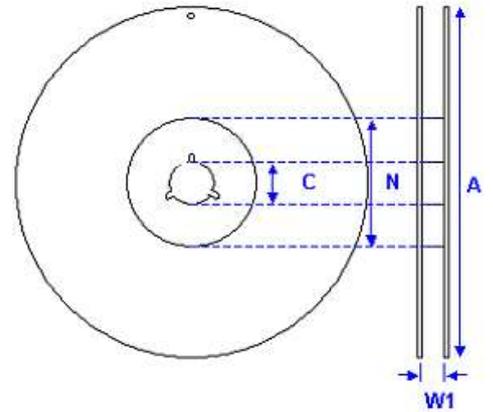
外型尺寸	1210		1808		1812	
芯片厚度	0.95±0.10 1.25±0.10 1.60±0.20	2.50±0.30	1.25±0.10 1.60±0.20	2.00±0.20	1.25±0.10 1.60±0.20 2.00±0.20	2.50±0.30
A ₀	<3.05	<3.10	<2.50	<2.50	<3.90	<3.90
B ₀	<3.80	<4.00	<5.30	<5.30	<5.30	<5.30
T	0.23±0.05	0.23±0.05	0.25±0.05	0.25±0.05	0.25±0.05	0.25±0.05
K ₀	<2.50	<3.50	<2.50	<2.50	<2.50	<3.00
W	8.00±0.10	8.00±0.10	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20
P ₀	4.00±0.100	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
10×P ₀	40.00±0.20	40.0±0.10	40.0±0.20	40.0±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20
P ₁	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10
P ₂	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05
D ₀	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0	1.50±0.10/-0
D ₁	1.00±0.10	1.00±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50+/-0.10
E	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75+/-0.1
F	3.50±0.05	3.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50+/-0.05
尺寸单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm

9. 包装尺寸规格及数量

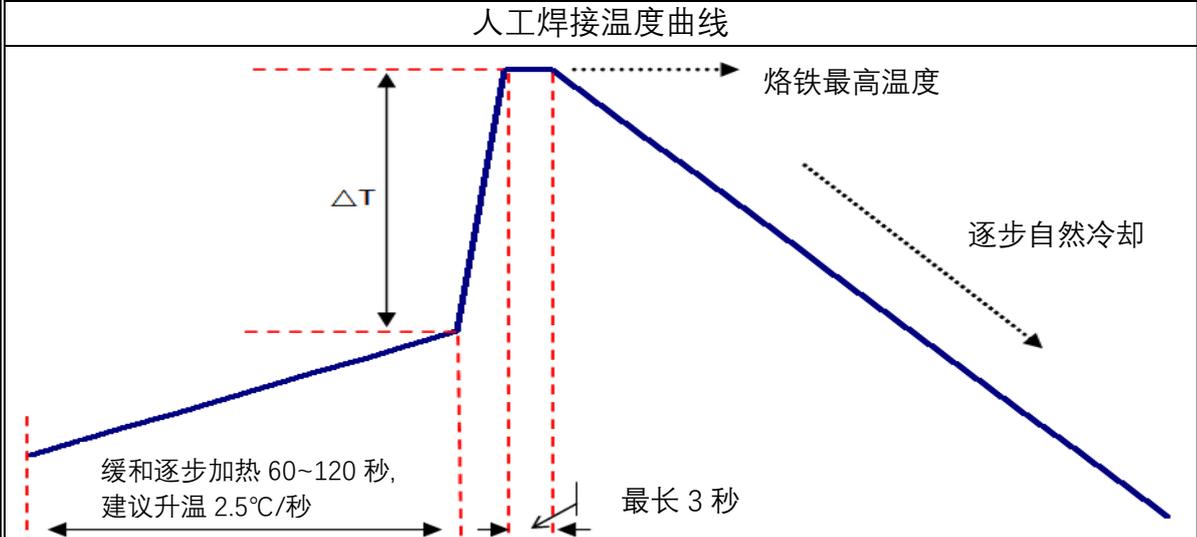
芯片厚度	1825		2211		2220		2225	
	1.60±0.20 1.60±0.20 2.00±0.20	2.50±0.30	2.00±0.20	2.50±0.20	2.00±0.20 1.60±0.20	2.50±0.30	1.60±0.20 2.00±0.20	2.50±0.30
A ₀	<6.80	<6.80	< 3.30	< 3.30	<5.80	<5.80	<6.80	<6.80
B ₀	<5.30	<5.30	< 6.50	< 6.50	<6.50	<6.50	<6.50	<6.50
T	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10	0.30±0.10
K ₀	<2.50	<3.10	<2.50	< 3.10	<2.50	<3.10	<2.50	<3.10
W	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20	12.0±0.20
P ₀	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10	4.00±0.10
10xP ₀	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20	40.00±0.20
P ₁	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10	8.00±0.10
P ₂	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05	2.00±0.05
D ₀	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0	1.50+0.10/-0
D ₁	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10
E	1.75±0.1	1.75±0.10	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.1	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10
F	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05	5.50±0.05
尺寸单位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

卷轮尺寸

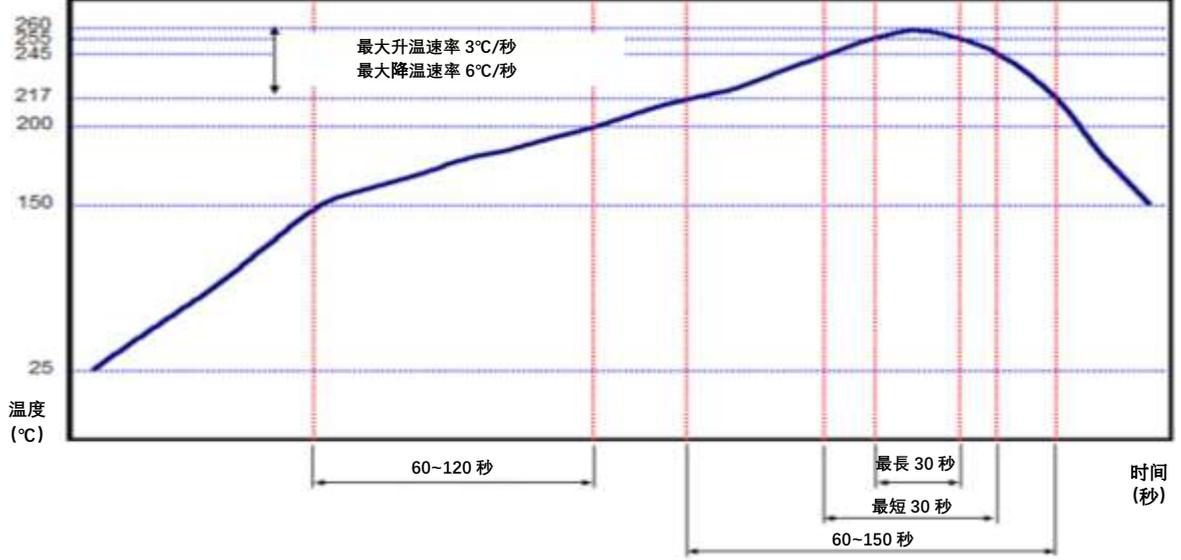
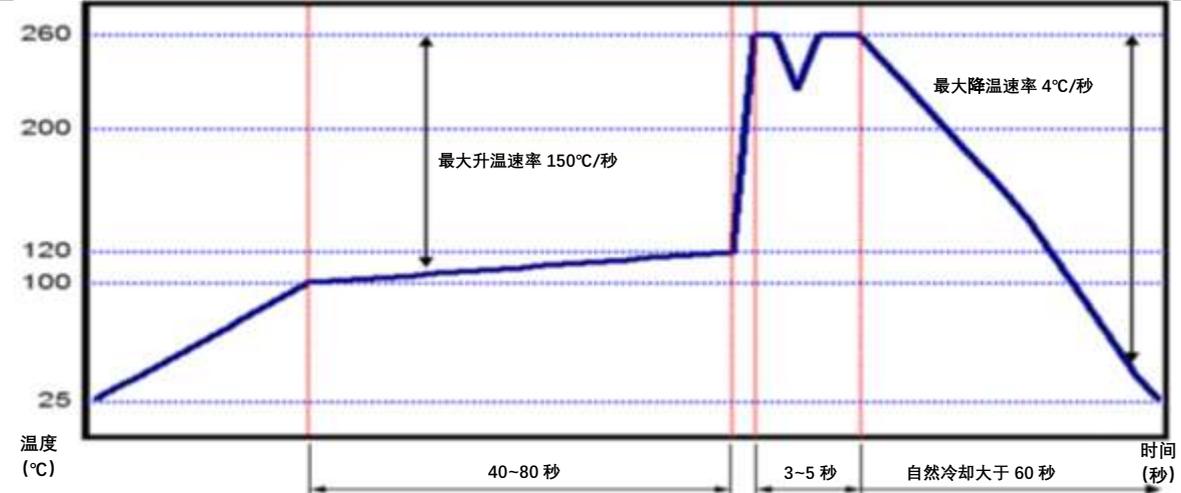
外型尺寸	0603, 0805, 1206, 1210			1808, 1812, 1825, 2211, 2220, 2225
卷轮尺寸	7"	7"	13"	7"
C	13.0 +0.5/-0.2	13.0 +0.5/-0.2	13.0 +0.5/-0.2	13.0 +0.5/-0.2
W ₁	8.4 +1.5/-0	8.4 +1.5/-0	8.4 +1.5/-0	12.4 +2.0/-0
A	178.0 ±0.10	178.0 ±0.10	330.0 ±1.0	178.0 ±0.10
N	60.0 +1.0/-0	80.0 ±1.0	100 ±1.0	60.0 +1.0/-0



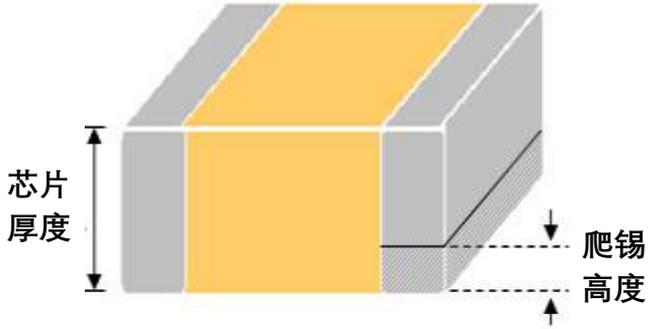
10. 产品使用说明

序号	项目	说明												
10.1.	存储	1. 为防止端电极的可焊性遭到破坏，建议储存条件如下： 室内环境：温度：5~40℃ / 湿度：20%~70%RH。 应避免电容器在硫酸、氨、硫化氢或氯等腐蚀性环境中存放。 2. 在使用电容器之前，不应打开包装。如果打开，包装应在切实可行的范围内尽快重新密封。 3. 卷装包装或散装包装产品不可存放在阳光直射的环境中。这可能会造成包材老化或胶带附着性能恶化，甚至造成产品端电极氧化失效。 4. 建议产品自交货后 12 个月内使用完毕，使用前检测可焊性。												
10.2.	使用处理	积层陶瓷电容的材料具有密度高、坚硬、易碎、易磨损等特性，容易受机械作用损坏造成破损或裂痕。因此元件必须小心使用，避免污染或碰撞。建议使用真空吸取或塑胶夹具取放元件。载带包装的卷装产品适用于自动化生产。												
10.3.	作业预热处理	为了降低及避免焊接过程中的温度热冲击影响，需要控制预热温度条件，预热区段的温度升温速度不可大于 3℃。												
10.4.	焊锡作业	作业时应使用无活性松香助焊剂和弱活性松香助焊剂，切勿使用活性助焊剂。 为防止因焊料引起芯片和基板之间的应力影响而造成元件的损坏，作业中必须衡量并控制每个焊点的焊料使用比率。 1.人工焊接作业标准： <div style="text-align: center;">  <p>人工焊接温度曲线</p> <p>图中显示温度随时间变化的曲线。曲线分为三个阶段：1. 缓和逐步加热阶段，标注为“缓和逐步加热 60~120 秒，建议升温 2.5℃/秒”；2. 峰值阶段，标注为“最长 3 秒”，达到“烙铁最高温度”；3. 冷却阶段，标注为“逐步自然冷却”。图中还标有温差 ΔT。</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>芯片尺寸</th> <th>预热温度</th> <th>ΔT (温差)</th> <th>烙铁最高温度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1206</td> <td>$\geq 150^\circ\text{C}$</td> <td>$\leq 150^\circ\text{C}$</td> <td>$\leq 350^\circ\text{C}$</td> </tr> <tr> <td>1210~2225</td> <td>$\geq 150^\circ\text{C}$</td> <td>$\leq 130^\circ\text{C}$</td> <td>$\leq 280^\circ\text{C}$</td> </tr> </tbody> </table> <p>*烙铁末端直径需 $\leq 1.0\text{mm}$，且加热功率不可大于 20 瓦。 *芯片必须用烙铁末端在未接触元件的情况下以适合的温度曲线进行预热。 *欲焊接的锡必须先附在烙铁末端再进行焊接，且烙铁不可直接接触芯片本体。 *焊接后元件必须在常温中自然冷却，切勿借助外力强制吹风冷却。</p>	芯片尺寸	预热温度	ΔT (温差)	烙铁最高温度	≤ 1206	$\geq 150^\circ\text{C}$	$\leq 150^\circ\text{C}$	$\leq 350^\circ\text{C}$	1210~2225	$\geq 150^\circ\text{C}$	$\leq 130^\circ\text{C}$	$\leq 280^\circ\text{C}$
芯片尺寸	预热温度	ΔT (温差)	烙铁最高温度											
≤ 1206	$\geq 150^\circ\text{C}$	$\leq 150^\circ\text{C}$	$\leq 350^\circ\text{C}$											
1210~2225	$\geq 150^\circ\text{C}$	$\leq 130^\circ\text{C}$	$\leq 280^\circ\text{C}$											

10. 产品使用摘要

序号	项目	说明																																																						
10.4.	焊锡作业	2.回流焊接作业标准:  <p>温度 (°C)</p> <p>时间 (秒)</p> <p>最大升温速率 3°C/秒 最大降温速率 6°C/秒</p> <p>60~120 秒</p> <p>最长 30 秒 最短 30 秒 60~150 秒</p> <p>锡 / 银 / 铜 材质 适用焊锡膏 (无铅)</p>																																																						
		3.波峰焊接作业标准:  <p>温度 (°C)</p> <p>时间 (秒)</p> <p>最大升温速率 150°C/秒 最大降温速率 4°C/秒</p> <p>40~80 秒</p> <p>3~5 秒</p> <p>自然冷却大于 60 秒</p> <p>锡 / 银 / 铜 材质 适用焊锡膏 (无铅)</p>																																																						
		4.焊接作业方式适用性: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">芯片尺寸</th> <th rowspan="2">介电类别.</th> <th rowspan="2">电容量</th> <th colspan="2">作业方式</th> </tr> <tr> <th>波峰焊</th> <th>回流焊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0402</td> <td>1 类</td> <td>全范围</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>0603~1206</td> <td>1 类</td> <td>全范围</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>≥1210</td> <td>1 类</td> <td>全范围</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0402</td> <td>2 类</td> <td>全范围</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2 类</td> <td>Cap. < 2.2μF</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0603</td> <td>2 类</td> <td>Cap. ≥ 2.2μF</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2 类</td> <td>Cap. < 4.7μF</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">0805~1206</td> <td>2 类</td> <td>Cap. ≥ 4.7μF</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2 类</td> <td>全范围</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>≥1210</td> <td>2 类</td> <td>全范围</td> <td>X</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	芯片尺寸	介电类别.	电容量	作业方式		波峰焊	回流焊	0402	1 类	全范围	X	○	0603~1206	1 类	全范围	○	○	≥1210	1 类	全范围	X	○	0402	2 类	全范围	X	○	2 类	Cap. < 2.2μF	○	○	0603	2 类	Cap. ≥ 2.2μF	X	○	2 类	Cap. < 4.7μF	○	○	0805~1206	2 类	Cap. ≥ 4.7μF	X	○	2 类	全范围	X	○	≥1210	2 类	全范围	X	○
		芯片尺寸				介电类别.	电容量	作业方式																																																
波峰焊	回流焊																																																							
0402	1 类	全范围	X	○																																																				
0603~1206	1 类	全范围	○	○																																																				
≥1210	1 类	全范围	X	○																																																				
0402	2 类	全范围	X	○																																																				
	2 类	Cap. < 2.2μF	○	○																																																				
0603	2 类	Cap. ≥ 2.2μF	X	○																																																				
	2 类	Cap. < 4.7μF	○	○																																																				
0805~1206	2 类	Cap. ≥ 4.7μF	X	○																																																				
	2 类	全范围	X	○																																																				
≥1210	2 类	全范围	X	○																																																				

10. 产品使用摘要

序号	项目	说明
10.4.	焊锡作业	5.爬锡高度: 
		建议最小爬锡高度至少 1/4 芯片厚度, 或 500um 高度水准.取任一较小值 (以上判定参照 IPC-610E)
		5.冷却处理: 焊锡后芯片及基板的冷却必须在自然降温的方式进行。 建议在常温中自然降温以缓和应力的影响。
		6.清洁: 所有助熔剂残留物必须使用合适的电子级蒸汽清洗溶剂去除, 以消除可能导致电解表面腐蚀的污染。采用超声波清洗溶剂可获得较好的清洗效果。选择合适的清洁系统取决于多种因素, 如组分配比、焊剂、焊膏和组装方法等。清洗系统从芯片下面去除助熔剂、残留物和污染的能力是非常重要的。